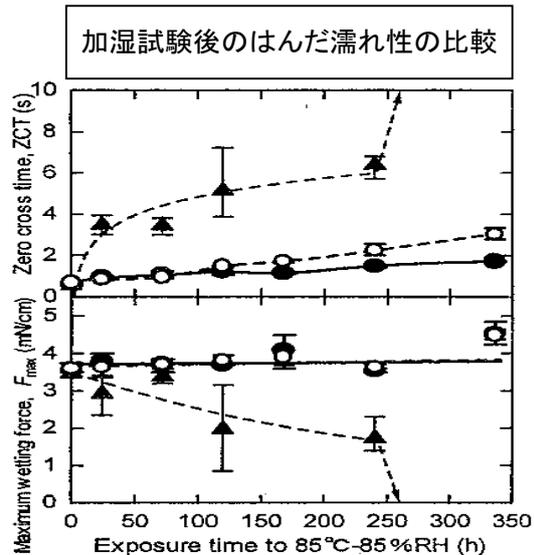


環境に優しく、接合強度に優れた

Sn-Ag系鉛フリーはんだめっき

有利于环境、优越的接合强度锡银无铅焊接电镀



加湿試験後の焊接濡湿性の比較

● 锡 - 银复合电镀, ○ 锡电镀, ▲ 铜

1. 技术摘要

铅对环境污染问题已被重视, 无铅焊接材料的实用, 正在不断地进展。在各种代替的合金中, 从锡、银合金的接合强度, 锡金属线等对策的特点上, 将成为有力的候选材料。但是因锡和银的标准电极电位差很大, 所以作为合金电镀, 析出是很难的。这项技术, 把毫微米程度的银粒子, 使复合电镀和锡共析, 解决了难题。现在还正是开发阶段, 安定地供应工业的需求还是很难的。作为无铅焊接是很有期望的。

(大阪市立工业研究所共同研究开发)

2. 产品特点

- ① 焊接濡湿性良好⇒温度试验后也实现了3秒钟以内为零
- ② 焊接接合强度很强
- ③ 熔点: 共晶点为96.5Sn3.5Ag221°C

2. 适用产品

需要焊接接合的所有小型电子零部件, 这项技术是根据盒式转动镀金来设想总括处理。关于大型零部件也接受商谈。

~ 向不可能挑战 ~

株式会社 友电舎

大阪市此花区常吉2-4-8

tel 06-6465-1663 fax 06-6468-5600

e-mail : ydn@pearl.ocn.co.jp (商业)

toiawase@ydn.co.jp